

インテル® プログラマブル・アクセラレーション・カード (インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版)

製品紹介

インテル® PAC インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版は、インテル® アクセラレーション・スタック(インテル® Xeon® CPU & FPGA 対応)でサポートされるプラットフォームの1つです。このPCIe* 対応のデータセンター向けFPGAアクセラレーション・カードは、FPGAの性能を活かしたアクセラレーションを多目的に提供し、インライン・アクセラレーションとルックアサイド・アクセラレーションの両方の用途で使用可能です。このアクセラレーション・スタックには、ドライバー、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)、FPGAインターフェイス・マネージャーが含まれており、アプリケーション開発者とアクセラレーター機能開発者の両者に共通の開発インターフェイスを提供します。アクセラレーション・ライブラリーや開発ツールとともに使用することで、開発期間を短縮し、複数のインテル® FPGAプラットフォーム間でのコードの再利用を可能にします。このカードは、そのハーフレングスの形状、低消費電力、パッシブ・ヒート・シンクなどの特長により、さまざまなサーバーへの導入が可能です。

対象となるアプリケーション

- ビッグデータ分析
- 機械学習(AI)
- ビデオ・トランスコード
- サイバー・セキュリティ
- ゲノム解析、石油/ガス探査などのハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)
- 金融テクノロジー(FinTech)

主なコンポーネントとインターフェイス

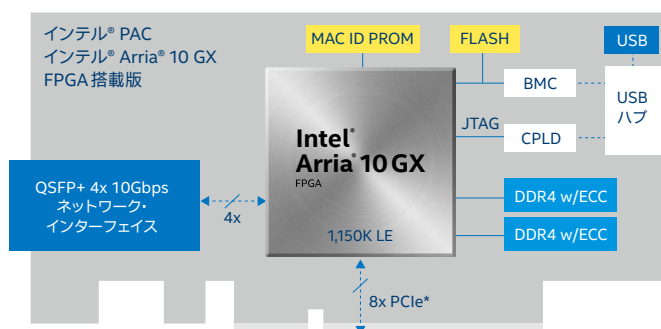
- インテル® Arria® 10 GX FPGA : 10AX115N2F40E2LG
- エラー訂正コード(ECC)対応 8 GB DDR4 メモリーバンク(2バンク)
- 128 MB フラッシュ
- 最大 40 Gbps の QSFP インターフェイス
- PCI Express*(PCIe*)x8 Gen3 インターフェイス・フォームファクター
- ハーフレングス・カード、標準(フルハイト)とロープロファイル(ハーフハイト)
- PCIe* x16 メカニカル

ボード管理

- Platform Level Data Model (PLDM)

消費電力/温度

- 60W の TDP、70W のピーク電力
- 55°C TLA、650 LFM
- 45 W の FPGA の消費電力を想定して設計されたパッシブ・ヒート・シンク



FPGA インターフェイス・マネージャー

- インテル® FPGA 用の共通の開発インターフェイス
- アプリケーション・ワークロードのアクセラレーション要求に合わせて動的にFPGAを再構成

アクセラレーション機能開発者向けの開発ツールとライブラリー

- インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアおよびインテル® FPGA SDK for OpenCL™
- Open Programmable Acceleration Engine (OPAE) <https://01.org/OPAE/>
- インテル提供のライブラリー
- アクセラレーション機能とホスト・アプリケーションのコミュニケーションが可能

入手方法

- エンジニアリング・サンプル出荷中
- 製品版 PAC は一部のOEM経由で発売
- 詳細はインテルの営業担当者にお問い合わせください。

詳細情報

- <http://www.intel.co.jp/arria10pac/>

ここに記載されているすべての情報は、予告なく変更されることがあります。インテルの最新の製品仕様およびロードマップをご希望の方は、インテルの担当者までお問い合わせください。OpenCL および OpenCL ロゴは Apple Inc. の商標であり、Khronos の許可を得て使用しています。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Arria、Quartus、Xeon は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

©2018 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。